

12. Dezember 2024

Neuer Silikon-Gap-Filler von Wevo: innovative Lösung für das Wärmemanagement elektronischer Komponenten

Ostfildern-Kemnat, Baden-Württemberg. Mit WEVOSIL 26040 FL erweitert Wevo sein Portfolio an Thermal-Interface-Materialien (TIM) um einen speziell optimierten Silikon-Gap-Filler. Das Material zeichnet sich durch eine hohe Wärmeleitfähigkeit von 4 W/m*K, eine sehr geringe Bond Line Thickness (< 70 µm) sowie eine optimierte Sedimentationsstabilität aus. Zusätzlich wurde das Dosierprofil für einen effizienten Produktionsprozess optimiert. Damit bietet das neue Wärmeleitmaterial eine prozess- und anwendungsoptimierte Lösung für das Wärmemanagement zahlreicher elektrischer und elektronischer Anwendungen von Leistungselektronik bis hin zu Batterietechnologien.

Ob hohe Dosiervolumina, eine zuverlässige Wärmeableitung für große Flächen oder mechanisch anspruchsvolle thermische Verbindungen – der neue Silikon-Gap-Filler von Wevo ist eine moderne Lösung für zahlreiche Anforderungen im Bereich moderner Elektronik und Elektrotechnik. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 4 W/m*K, gemessen nach ASTM D5470-2017, sorgt das Produkt für eine effiziente Wärmeableitung und überbrückt auch kleine Spalte aufgrund der eigens entwickelten Füllstoffkombination sowie der daraus resultierenden sehr geringen Bond Line Thickness von < 70 µm. Außerdem können Materialeigenschaften wie die Reaktivität individuell angepasst werden.

Thermal-Interface-Material mit optimiertem Dosierprofil

Gleichzeitig wurde das Material sehr sedimentationsstabil formuliert und kann daher mindestens drei Monate lang ohne Aufarbeitung gelagert, eingesetzt und somit auch über weite Strecken transportiert werden. Die optimierten Dosiereigenschaften ermöglichen zudem ein einfaches und effizientes Handling, hohe Dosiergeschwindigkeiten und feine Dosiermuster. Dies sorgt im Vergleich zu wärmeleitfähigen Pads für eine deutlich höhere Präzision und Flexibilität in der Produktion, was insbesondere bei hohen Stückzahlen von Vorteil ist.

Darüber hinaus bietet der neu entwickelte Silikon-Gap-Filler eine hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 200 °C, flammhemmende Eigenschaften nach UL 94 V-0 (bereits bei 2 mm Dicke) und gute mechanische Eigenschaften, darunter eine Reißdehnung von mehr als 30 Prozent. Im ausgehärteten Zustand erfüllt WEVOSIL 26040 FL die in der Automobilindustrie geltenden Anforderungen der

12. Dezember 2024

Prüfnorm PV 3040 an eine geringe Emission flüchtiger Substanzen („low volatile“) und eignet sich damit für vielseitige Einsatzbereiche.

Mit seinen modernen, anpassbaren Eigenschaften unterstützt das neue Wärmeleitmaterial von Wevo den sicheren Betrieb und die Langlebigkeit innovativer Elektronik- und Elektrotechnik-Komponenten.

Bildunterschrift und -quelle

Von Batterietechnologien bis Leistungselektronik: Der neue Silikon-Gap-Filler von Wevo ermöglicht ein effizientes Wärmemanagement (Bildquelle: WEVO-CHEMIE GmbH).

(Bitte beachten Sie, dass das Bild ausschließlich im Rahmen dieser Pressemitteilung genutzt werden darf.)

Über Wevo

Die WEVO-CHEMIE GmbH ist ein international tätiges, unabhängiges Chemie-Unternehmen mit Sitz in Deutschland und weiteren Unternehmen in Asien, China und den USA. Wevo entwickelt und fertigt innovative Vergussanwendungen sowie spezielle Kleb- und Dichtstoffe auf Basis von Polyurethan, Epoxid und Silikon – vorwiegend für individuelle Anwendungen in elektrischen und elektronischen Bauteilen. Wevo-Produkte schützen empfindliche Komponenten vor Chemikalien, Vibration, Fremdkörpern, Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen.

Pressekontakt

Alexandra Heißenbüttel

Dr. Neidlinger Consulting

Tel.: +49 711 167 61 712

E-Mail: presse@wevo-chemie.de